

2014-2020年中国半导体分立器件市场深度调研与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2014-2020年中国半导体分立器件市场深度调研与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/dianzi1410/Q87504FM3F.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-10-10

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2020年中国半导体分立器件市场深度调研与投资前景研究报告》共八章。首先介绍了半导体分立器件相关概述、中国半导体分立器件市场运行环境等，接着分析了中国半导体分立器件市场发展的现状，然后介绍了中国半导体分立器件重点区域市场运行形势。随后，报告对中国半导体分立器件重点企业经营状况分析，最后分析了中国半导体分立器件行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体分立器件产业有个系统的了解或者想投资半导体分立器件行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

半导体产业的发展始于分立器件，半导体分立器件作为半导体产业的两大分支之一，具有广泛的应用范围和不可替代性。半导体分立器件种类繁多，包括功率半导体分立器件，特殊器件及传感器，敏感器件，小功率半导体分立器件，碳化硅、氮化镓等宽禁带功率半导体分立器件和半导体光电器件六大类别。电力电子技术用于电能分配、转换和控制，通过高效率地变换电能，将“粗电”变为“精电”，使电子产品和电力设备更加精准地达到使用目标，如通过变频进行调速，使变频空调在节能70%的同时更安静，令人感觉更舒适；豆浆机、电磁炉、电烤箱等小家电在人们生活中的普及率越来越高，功率半导体分立器件在小家电中的应用，增加了人们使用小家电时的方便性和安全性，生活质量得到提升；手机的功能越来越多，同时更加轻巧，很大程度上得益于功率半导体研发和超大规模集成电路的发展的进步；同时，人们希望一次充电后有更长的使用时间，在电池技术没有革命性进步以前，需要更高性能的功率半导体分立器件进行高效的电源管理。

电能是人类消耗的最重要能源，无论是水电、核电、火电还是风电，甚至各种电池提供的化学电能，大部分均无法直接使用，目前，发达国家电能的75%需要经过功率半导体分立器件变换或控制后使用。功率半导体分立器件通过降低电子产品、电力设备的电能损耗，实现节能环保，是电能控制系统节能减排的基础技术和核心技术。

2006-2013年中国半导体分立器件产业产量增长状况分析

资料来源：博思数据整理

2013年我国功率半导体分立器件产业产量为4,605.97亿只，与2012年相比增长了11.10%，销售收入为1,535.95亿元，较2012年同比增长了10.50%。随着国内节能环保、新能源、新能源汽车等下游应用产业的快速发展，以及国家产业政策对下游新兴产业的大力支持和对传统行业的升级改造，我国半导体分立器件市场的销售将随之稳步增长。

2006-2016年中国半导体分立器件产业销售额增长状况及发展预测

资料来源：博思数据整理

第1章：半导体分立器件制造行业发展环境分析

1.1 行业定义及产品分类

1.1.1 半导体分立器件制造行业定义

1.1.2 半导体分立器件制造行业产品分类

1.2 行业政策环境分析

1.2.1 行业相关政策分析

1.2.2 行业相关发展规划

1.3 行业经济环境分析

1.3.1 宏观经济与行业的相关性分析

（1）GDP与行业的相关性分析

（2）工业增加值与行业的相关性分析

（3）固定资产投资与行业的相关性分析

1.3.2 宏观经济发展展望

1.4 行业技术环境分析

1.4.1 行业专利申请数分析

1.4.2 行业专利公开数量变化情况

1.4.3 行业专利申请人分析

1.4.4 行业热门技术分析

第2章：半导体分立器件制造行业原材料市场分析

2.1 行业产业链简介

2.2 行业原材料市场分析

2.2.1 芯片市场发展情况分析

（1）芯片供应量分析

（2）芯片价格走势分析

2.2.2 金属硅市场发展情况分析

（1）金属硅产量分析

（2）金属硅消费量分析

（3）金属硅出口量分析

(4) 金属硅价格变动情况

2.2.3 铜材市场发展情况分析

(1) 铜材产量分析

(2) 铜表观消费量分析

(3) 铜材进出口分析

(4) 铜价格变动情况

2.3 原材料对行业的影响

第3章：半导体分立器件制造行业现状及预测

3.1 半导体分立器件制造行业经营情况分析

3.1.1 半导体分立器件制造行业发展总体概况

3.1.2 半导体分立器件制造行业发展主要特点

3.1.3 半导体分立器件制造行业市场规模分析

3.1.4 半导体分立器件制造行业财务指标分析

(1) 半导体分立器件制造行业盈利能力分析

(2) 半导体分立器件制造行业运营能力分析

(3) 半导体分立器件制造行业偿债能力分析

(4) 半导体分立器件制造行业发展能力分析

3.1.5 行业不同规模企业主要经济指标分析

3.1.6 行业不同性质企业主要经济指标分析

3.2 半导体分立器件制造行业供需平衡分析

3.2.1 全国半导体分立器件制造行业供给情况分析

(1) 全国半导体分立器件制造行业总产值分析

(2) 全国半导体分立器件制造行业产成品分析

3.2.2 全国半导体分立器件制造行业需求情况分析

(1) 全国半导体分立器件制造行业销售产值分析

(2) 全国半导体分立器件制造行业销售收入分析

3.2.3 全国半导体分立器件制造行业产销率分析

3.3 半导体分立器件制造行业进出口市场分析

3.3.1 半导体分立器件制造行业进出口状况综述

3.3.2 半导体分立器件制造行业出口产品结构

3.3.3 半导体分立器件制造行业进口产品结构

3.3.4 半导体分立器件制造行业进出口前景及建议

(1) 半导体分立器件制造行业出口前景及建议

(2) 半导体分立器件制造行业进口前景及建议

3.3.5 半导体分立器件制造行业发展的驱动因素

3.3.6 半导体分立器件制造行业发展的障碍因素

3.3.7 半导体分立器件制造行业发展趋势分析

第4章：半导体分立器件制造行业竞争格局分析

4.1 行业总体竞争状况分析

4.2 行业国际市场竞争状况分析

4.2.1 国际半导体分立器件市场发展状况

4.2.2 国际半导体分立器件市场竞争状况

4.2.3 国际半导体分立器件市场发展趋势

4.2.4 跨国公司在华市场的投资布局

(1) 日本厂商在华投资布局分析

1) 东芝 (TOSHIBA)

2) 瑞萨科技 (RENESAS)

3) 罗姆 (Rohm)

4) 松下 (Panasonic)

5) 日本电气股份有限公司 (NEC)

6) 富士电机 (FujiElectric)

7) 三洋 (Sanyo)

8) 新电元 (ShindengenElectric)

9) 富士通 (Fujitsu)

(2) 美国厂商在华投资布局分析

1) 威旭 (Vishay)

2) 飞兆半导体 (FairchildSemiconductors)

3) 国际整流器公司 (InternationalRectifier)

4) 安森美 (OnSemiconductors)

(3) 欧洲厂商在华投资布局分析

1) 飞利浦半导体 (PhilipsSemiconductors)

2) 意法半导体 (STMicroelectronics)

3) 英飞凌 (InfineonTechnologies)

4.2.5 跨国公司在中国的竞争策略分析

4.3 行业国内市场竞争状况分析

4.3.1 国内半导体分立器件制造行业集中度

(1) 行业经济类型集中度分析

(2) 行业经济类型集中度变化情况

4.3.2 国内半导体分立器件制造行业竞争格局

4.3.3 行业国内市场五力模式分析

(1) 现有竞争者分析

(2) 潜在进入者威胁

(3) 供应商议价能力分析

(4) 购买商议价能力分析

(5) 替代品威胁分析

(6) 竞争情况总结

第5章：半导体分立器件应用市场发展情况分析

5.1 半导体分立器件产品概况

5.1.1 行业产品结构特征分析

5.1.2 半导体分立器件产量分析

5.2 半导体分立器件应用市场分析

5.2.1 电子设备制造对半导体分立器件需求分析

(1) 电子设备制造业发展现状

(2) 电子设备对半导体分立器件的需求

5.2.2 LED显示屏对半导体分立器件需求分析

(1) LED显示屏行业发展现状

(2) LED显示屏对半导体分立器件的需求

5.2.3 电子照明对半导体分立器件需求分析

(1) 电子照明行业发展现状

(2) 电子照明对半导体分立器件的需求

5.2.4 汽车电子对半导体分立器件需求分析

(1) 汽车电子行业发展现状

(2) 汽车电子对半导体分立器件的需求

第6章：半导体分立器件制造行业重点区域市场分析

6.1 行业区域市场总体发展状况

6.1.1 行业区域结构总体特征

6.1.2 行业区域集中度分析

6.2 行业重点区域经营情况分析

6.2.1 华北地区半导体分立器件制造行业经营情况

6.2.2 东北地区半导体分立器件制造行业经营情况

6.2.3 华东地区半导体分立器件制造行业经营情况

6.2.4 华中地区半导体分立器件制造行业经营情况

6.2.5 华南地区半导体分立器件制造行业经营情况

6.2.6 其他地区半导体分立器件制造行业经营情况

第7章：半导体分立器件制造领先企业生产经营分析

7.1 半导体分立器件制造企业概况

7.1.1 企业销售收入情况

7.1.2 企业利润总额情况

7.2 半导体分立器件制造行业领先企业个案分析

7.2.1 深圳赛意法微电子有限公司经营情况分析

（1）公司简介

（2）公司经营情况分析

（3）公司竞争优势分析

（4）公司主要经营业务分析

（5）公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.2 上海松下半导体有限公司经营情况分析

（1）公司简介

（2）公司经营情况分析

（3）公司竞争优势分析

（4）公司主要经营业务分析

（5）公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.3 苏州松下半导体有限公司经营情况分析

（1）公司简介

（2）公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.4 无锡华润华晶微电子有限公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.5 恩智浦半导体广东有限公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.6 通用半导体（中国）有限公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.7 英飞凌科技（无锡）有限公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.8 乐山无线电股份有限公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.9 江苏长电科技股份有限公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.10 上海凯虹科技电子有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构及新产品动向

(4) 企业经营状况优劣势分析

7.2.11 汕尾德昌电子有限公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.12 苏州固锝电子股份有限公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.13 新义半导体（苏州）有限公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.14 上海威旭半导体光电有限公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.15 吉林华微电子股份有限公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.16 洋半导体（蛇口）有限公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.17 中国瑞风银河新能源控股有限公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.18 西安永电电气有限责任公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.19 深圳市深爱半导体有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构及新产品动向

(4) 企业销售渠道与网络

(5) 企业经营状况优劣势分析

7.2.20 成都亚光电子股份有限公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.21 天津中环半导体股份有限公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.22 宁波明昕微电子股份有限公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.23 南通华达微电子集团有限公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

7.2.24 济南晶恒电子有限责任公司经营情况分析

(1) 公司简介

(2) 公司经营情况分析

(3) 公司竞争优势分析

(4) 公司主要经营业务分析

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析

第8章：博思数据关于半导体分立器件制造行业投资分析与建议

8.1 半导体分立器件制造行业投资特性分析

8.1.1 半导体分立器件制造行业进入壁垒分析

8.1.2 半导体分立器件制造行业盈利模式分析

8.1.3 半导体分立器件制造行业盈利因素分析

8.2 半导体分立器件制造行业投资兼并分析

8.2.1 行业投资兼并与重组整合概况

8.2.2 国内企业投资兼并与重组整合

8.2.3 行业投资兼并与重组整合特征

8.3 半导体分立器件制造行业投资机会与建议

8.3.1 半导体分立器件制造行业投资风险

8.3.2 半导体分立器件制造行业投资机会

8.3.3 半导体分立器件制造行业投资建议

图表目录

图表1：20项电子行业标准编号、名称、主要内容

图表2：2005-2013年中国GDP增长趋势图（单位：%）

图表3：2005-2013年中国GDP与半导体分立器件制造行业关联性对比图（单位：%）

图表4：2007-2013年全国规模以上企业工业增加值同比增速（单位：%）

图表5：2007-2013年中国工业增加值与半导体分立器件制造行业关联性对比图（单位：%）

图表6：2007-2013年全社会固定资产投资额名义同比增速（单位：%）

图表7：2007-2013年固定资产投资与半导体分立器件制造行业关联性对比图（单位：%）

图表8：2014年主要宏观经济数据及预测（单位：亿元，%）

图表9：2005-2013年我国半导体分立器件的发明专利申请数量变化图（单位：项）

图表10：2005-2013年我国半导体分立器件发明专利公开数量变化图（单位：项）

图表11：截至2013年我国半导体分立器件的发明专利申请人构成图（单位：项）

图表12：我国半导体分立器件的公开发明专利分布领域（单位：项）

图表13：半导体分立器件制造行业产业链简图

图表14：2006-2013年半导体照明用外延芯片产值增长情况（单位：亿元，%）

图表15：2012-2013年华强北芯片价格指数变动情况

图表16：2013年国内工业硅产量表（单位：万吨）

图表17：2013年我国金属硅出口情况（单位：吨，美元/吨）

图表18：2012-2013年金属硅出口均价变动情况（单位：吨，美元/吨）

图表19：2013年国内工业硅价格走势图（单位：元/吨）

图表20：2007-2013年我国铜材产量及增速变化趋势图（单位：万吨，%）

图表21：2007-2013年我国铜材进口数量增长情况（单位：万吨，%）

图表22：2007-2013年我国铜材出口数量增长情况（单位：万吨，%）

图表23：2012-2013年华东市场铜（市场）价格月涨跌图（单位：%）

图表24：2013年铜价格走势情况（单位：元/吨）

图表25：原材料对半导体分立器件制造行业的影响分析

图表26：2012-2013年半导体分立器件制造行业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）

图表27：2012-2013年中国半导体分立器件制造行业盈利能力分析（单位：%）

图表28：2012-2013年中国半导体分立器件制造行业运营能力分析（单位：次）

图表29：2012-2013年中国半导体分立器件制造行业偿债能力分析（单位：%、倍）

图表30：2012-2013年中国半导体分立器件制造行业发展能力分析（单位：%）

图表31：不同规模企业数量比重变化趋势图（单位：%）

图表32：不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位：%）

图表33：不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%）

图表34：不同规模企业利润总额比重变化趋势图（单位：%）

图表35：不同性质企业数量比重变化趋势图（单位：%）

图表36：不同性质企业资产总额比重变化趋势图（单位：%）

图表37：不同性质企业销售收入比重变化趋势图（单位：%）

图表38：不同性质企业利润总额比重变化趋势图（单位：%）

图表39：2008-2013年中国半导体分立器件制造行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%）

图表40：2008-2013年中国半导体分立器件制造行业产成品及增长率走势图（单位：亿元，%）

图表41：2008-2013年中国半导体分立器件制造行业销售产值及增长率变化情况（单位：亿元，%）

图表42：2008-2013年中国半导体分立器件制造行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%）

图表43：2004年以来全国半导体分立器件制造行业产销率变化趋势图（单位：%）

图表44：2012-2013年中国半导体分立器件制造行业进出口状况表（单位：万美元）

图表45：2012-2013年中国半导体分立器件制造行业出口产品（单位：万个，吨，万只，万美元）

更多图表 ……

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/dianzi1410/Q87504FM3F.html>